

2024-2030年中国芯片产业 发展现状与产业竞争格局报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国芯片产业发展现状与产业竞争格局报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/414153.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

芯片（chip）就是半导体元件产品的统称，是集成电路的载体，由晶圆分割而成。芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节，其中晶片制作过程尤为的复杂。

从全球看，2021年，全球芯片销售额达到创纪录的5559亿美元，同比增长26.2%。从国内看，受益于政策的大力扶持，近年来中国芯片产业销售额增长迅速，市场空间广阔。2021年，中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。2022年上半年，中国集成电路产业的销售额达到4763.5亿元，同比增长16.1%。从销售额结构来看，2021年中国设计业销售额占集成电路产业总销售额的43%，与2020年基本持平；制造业销售额占集成电路产业总销售额的30%，较2020年增长了1%；封装测试业销售额占集成电路产业总销售额的26%，较2020年减少了2%。从企业数量看，截至2023年2月3日，我国共有关键词为“芯片”的在业存续/企业17.1万家。2020年开始，芯片企业注册量呈井喷式增长，2022年，我国芯片相关企业注册数量达到5.96万家。

在政策方面，2022年1月12日，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，指出要加快推动数字产业化，增强关键技术创新能力，提升核心产业竞争力。2022年3月12日，在第十三届全国人民代表大会第五次会议上，其中提到加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片产业发展现状与产业竞争格局报告》共十四章。首先介绍了芯片行业的总体概况及全球行业发展形势，接着分析了中国芯片行业发展环境、芯片市场总体发展状况。然后分别对芯片产业的设计、制造、封测市场及相关重点企业进行了详尽的透析。最后，报告对芯片行业进行了投资分析并对行业未来发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中国海关总署、半导体行业协会、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对芯片行业有个系统深入的了解、或者想投资芯片相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录：

第一章 芯片行业的总体概述

1.1 相关概念

- 1.1.1 芯片的内涵
- 1.1.2 集成电路的内涵
- 1.1.3 两者的联系与区别
- 1.2 常见类型
 - 1.2.1 LED芯片
 - 1.2.2 手机芯片
 - 1.2.3 电脑芯片
 - 1.2.4 大脑芯片
 - 1.2.5 生物芯片
- 1.3 制作过程
 - 1.3.1 原料晶圆
 - 1.3.2 晶圆涂膜
 - 1.3.3 光刻显影
 - 1.3.4 掺杂杂质
 - 1.3.5 晶圆测试
 - 1.3.6 芯片封装
 - 1.3.7 测试包装
- 1.4 芯片上下游产业链分析
 - 1.4.1 产业链结构
 - 1.4.2 上下游企业

第二章 2021-2023年全球芯片产业发展分析

- 2.1 2021-2023年世界芯片市场综述
 - 2.1.1 市场发展历程
 - 2.1.2 芯片生产周期
 - 2.1.3 芯片销售规模
 - 2.1.4 芯片资本支出
 - 2.1.5 芯片供需现状
 - 2.1.6 市场竞争格局
 - 2.1.7 芯片设计现状
 - 2.1.8 芯片制造产能
 - 2.1.9 产业发展趋势

- 2.1.10 市场规模预测
- 2.2 美国芯片产业分析
 - 2.2.1 产业发展优势
 - 2.2.2 产业发展特点
 - 2.2.3 产业发展历程
 - 2.2.4 行业地位分析
 - 2.2.5 政策布局加快
 - 2.2.6 产业发展规模
 - 2.2.7 研发支出规模
 - 2.2.8 企业布局动态
 - 2.2.9 机构发展动态
 - 2.2.10 产业战略合作
 - 2.2.11 芯片法案影响
- 2.3 日本芯片产业分析
 - 2.3.1 产业发展特点
 - 2.3.2 产业发展历程
 - 2.3.3 政府扶持政策
 - 2.3.4 市场发展规模
 - 2.3.5 芯片企业排名
 - 2.3.6 企业经营状况
 - 2.3.7 企业收购动态
 - 2.3.8 产业发展启示
- 2.4 韩国芯片产业分析
 - 2.4.1 产业发展阶段
 - 2.4.2 政府扶持政策
 - 2.4.3 行业发展地位
 - 2.4.4 芯片供应情况
 - 2.4.5 芯片出口现状
 - 2.4.6 市场竞争格局
 - 2.4.7 芯片投资情况
 - 2.4.8 产业发展经验
 - 2.4.9 市场发展策略

2.5 印度芯片产业分析

2.5.1 产业发展优势

2.5.2 电子产业发展

2.5.3 行业政策支持

2.5.4 市场需求状况

2.5.5 行业发展现状

2.5.6 产业发展挑战

2.5.7 芯片发展战略

2.6 中国台湾芯片产业分析

2.6.1 台湾芯片行业地位

2.6.2 台湾芯片产业产值

2.6.3 台湾晶圆代工产能

2.6.4 台湾芯片竞争格局

2.6.5 重点企业技术水平

第三章 2021-2023年中国芯片产业发展环境分析

3.1 经济环境分析

3.1.1 国内宏观经济

3.1.2 对外经济分析

3.1.3 固定资产投资

3.1.4 工业运行情况

3.1.5 宏观经济展望

3.2 社会环境分析

3.2.1 互联网加速发展

3.2.2 信息化发展水平

3.2.3 电子信息制造情况

3.2.4 研发经费投入增长

3.2.5 科技人才队伍壮大

3.2.6 万物互联带来需求

3.2.7 中美贸易战影响

3.3 技术环境分析

3.3.1 芯片技术研发进展

- 3.3.2 5G技术助力产业分析
- 3.3.3 后摩尔时代颠覆性技术
- 3.3.4 芯片技术发展方向分析
- 3.4 专利环境分析
 - 3.4.1 专利申请数量
 - 3.4.2 专利技术分布
 - 3.4.3 专利权人情况
 - 3.4.4 上市公司专利
 - 3.4.5 布图设计专利
- 3.5 产业环境
 - 3.5.1 半导体产业链条
 - 3.5.2 半导体材料市场
 - 3.5.3 半导体设备市场
 - 3.5.4 半导体资本开支
 - 3.5.5 半导体销售规模
 - 3.5.6 半导体产品结构
 - 3.5.7 半导体竞争格局
 - 3.5.8 半导体发展借鉴

第四章 2021-2023年中国芯片产业发展分析

- 4.1 2021-2023年中国芯片产业发展状况
 - 4.1.1 行业发展历程
 - 4.1.2 行业特点概述
 - 4.1.3 产业发展背景
 - 4.1.4 产业发展意义
 - 4.1.5 市场销售收入
 - 4.1.6 产业结构分析
 - 4.1.7 下游应用分析
 - 4.1.8 芯片产量状况
 - 4.1.9 市场贸易状况
- 4.2 2021-2023年中国芯片市场格局分析
 - 4.2.1 芯片企业数量

- 4.2.2 企业区域分布
- 4.2.3 企业竞争格局
- 4.2.4 城市发展格局
- 4.2.5 行业竞争分析
- 4.3 2021-2023年中国芯片国产化进程分析
 - 4.3.1 核心芯片自给率低
 - 4.3.2 产品研发制造短板
 - 4.3.3 芯片国产化率分析
 - 4.3.4 芯片国产化的进展
 - 4.3.5 芯片国产化的问题
 - 4.3.6 芯片国产化未来展望
- 4.4 中国芯片产业发展困境分析
 - 4.4.1 国内外产业差距
 - 4.4.2 芯片供应短缺
 - 4.4.3 过度依赖进口
 - 4.4.4 技术短板问题
 - 4.4.5 人才短缺问题
 - 4.4.6 市场发展不足
- 4.5 中国芯片产业应对策略分析
 - 4.5.1 突破垄断策略
 - 4.5.2 化解供给不足
 - 4.5.3 加强自主创新
 - 4.5.4 加大资源投入
 - 4.5.5 人才培养策略
 - 4.5.6 总体发展建议

第五章 2021-2023年中国重点地区芯片产业发展分析

- 5.1 广东省
 - 5.1.1 产业支持政策
 - 5.1.2 发展条件分析
 - 5.1.3 产业发展现状
 - 5.1.4 市场产量规模

- 5.1.5 城市发展现状
- 5.1.6 竞争格局分析
- 5.1.7 项目投产动态
- 5.1.8 产业发展问题
- 5.1.9 发展模式建议
- 5.1.10 发展机遇与挑战
- 5.1.11 产业发展规划
- 5.2 北京市
 - 5.2.1 产业发展优势
 - 5.2.2 产量规模状况
 - 5.2.3 产业发展动态
 - 5.2.4 典型产业园区
 - 5.2.5 项目发展动态
 - 5.2.6 产业发展困境
 - 5.2.7 产业发展对策
 - 5.2.8 产业发展规划
- 5.3 上海市
 - 5.3.1 产业支持政策
 - 5.3.2 市场规模分析
 - 5.3.3 产量规模状况
 - 5.3.4 产业空间布局
 - 5.3.5 人才队伍建设
 - 5.3.6 产业发展规划
- 5.4 南京市
 - 5.4.1 江苏芯片产业
 - 5.4.2 产业发展优势
 - 5.4.3 产业扶持政策
 - 5.4.4 产业规模分析
 - 5.4.5 产业创新体系
 - 5.4.6 项目发展动态
 - 5.4.7 典型产业园区
 - 5.4.8 产业发展方向

5.4.9 产业发展规划

5.5 厦门市

5.5.1 福建芯片产业

5.5.2 产业扶持政策

5.5.3 产业发展实力

5.5.4 产业规模分析

5.5.5 区域发展格局

5.5.6 项目投资动态

5.5.7 产业发展规划

5.6 杭州市

5.6.1 浙江芯片产业

5.6.2 产业支持政策

5.6.3 产业发展载体

5.6.4 产业营收规模

5.6.5 项目发展动态

5.7 其他城市

5.7.1 武汉市

5.7.2 西安市

5.7.3 合肥市

5.7.4 重庆市

5.7.5 无锡市

5.7.6 天津市

5.7.7 晋江市

第六章 2021-2023年中国芯片设计及制造发展分析

6.1 2021-2023年中国芯片设计行业发展分析

6.1.1 芯片设计概述

6.1.2 市场发展规模

6.1.3 企业数量规模

6.1.4 产业区域布局

6.1.5 重点企业分析

6.1.6 设计人员需求

- 6.1.7 产品领域分布
- 6.1.8 企业融资动态
- 6.1.9 细分市场发展
- 6.1.10 未来发展趋势
- 6.2 2021-2023年中国晶圆代工产业发展分析
 - 6.2.1 晶圆制造工艺
 - 6.2.2 行业发展规模
 - 6.2.3 行业产能分布
 - 6.2.4 行业竞争格局
 - 6.2.5 应用领域分析
 - 6.2.6 工艺制程进展
 - 6.2.7 国内重点企业
 - 6.2.8 产能规模预测

第七章 2021-2023年中国芯片封装测试市场发展分析

- 7.1 中国芯片封装测试行业发展综述
 - 7.1.1 封装技术介绍
 - 7.1.2 芯片测试原理
 - 7.1.3 主要测试分类
 - 7.1.4 测试准备规划
 - 7.1.5 发展面临的问题
- 7.2 中国芯片封装测试市场分析
 - 7.2.1 全球市场状况
 - 7.2.2 全球竞争格局
 - 7.2.3 国内市场规模
 - 7.2.4 技术水平分析
 - 7.2.5 国内企业排名
 - 7.2.6 企业收购动态
 - 7.2.7 产业融资情况
- 7.3 中国芯片封测行业发展前景及趋势分析
 - 7.3.1 行业发展机遇
 - 7.3.2 行业发展前景

- 7.3.3 市场发展前景
- 7.3.4 技术发展趋势
- 7.3.5 产业趋势分析
- 7.3.6 产业发展方向

第八章 2021-2023年中国芯片产业应用市场分析

8.1 LED领域

- 8.1.1 产业发展状况
- 8.1.2 LED芯片规模
- 8.1.3 行业区域分布
- 8.1.4 市场竞争格局
- 8.1.5 企业业务布局
- 8.1.6 市场集中程度
- 8.1.7 行业产能分析
- 8.1.8 项目建设动态
- 8.1.9 封装技术难点
- 8.1.10 行业发展预测

8.2 物联网领域

- 8.2.1 产业链的地位
- 8.2.2 行业相关政策
- 8.2.3 竞争主体分析
- 8.2.4 物联网连接芯片
- 8.2.5 典型应用产品
- 8.2.6 行业竞争格局
- 8.2.7 行业发展动态
- 8.2.8 企业投资动态
- 8.2.9 产业发展关键
- 8.2.10 市场规模预测

8.3 无人机领域

- 8.3.1 无人机产业链
- 8.3.2 市场规模状况
- 8.3.3 行业注册情况

- 8.3.4 市场占比情况
- 8.3.5 市场竞争格局
- 8.3.6 主流解决方案
- 8.3.7 芯片应用领域
- 8.3.8 市场前景趋势
- 8.4 卫星导航领域
 - 8.4.1 北斗芯片概述
 - 8.4.2 产业发展状况
 - 8.4.3 芯片销量状况
 - 8.4.4 企业竞争格局
 - 8.4.5 芯片应用分析
 - 8.4.6 融资合作动态
 - 8.4.7 产业发展趋势
- 8.5 智能穿戴领域
 - 8.5.1 产业链构成
 - 8.5.2 产品类别分析
 - 8.5.3 市场规模状况
 - 8.5.4 市场竞争格局
 - 8.5.5 芯片研发动态
 - 8.5.6 芯片厂商对比
 - 8.5.7 发展潜力分析
 - 8.5.8 行业未来态势
- 8.6 智能手机领域
 - 8.6.1 出货规模分析
 - 8.6.2 产业发展现状
 - 8.6.3 智能手机芯片
 - 8.6.4 芯片销量情况
 - 8.6.5 企业竞争格局
 - 8.6.6 产品技术路线
 - 8.6.7 芯片评测状况
 - 8.6.8 芯片评测方案
 - 8.6.9 芯片研制进程

- 8.7 汽车电子领域
 - 8.7.1 行业发展状况
 - 8.7.2 市场规模状况
 - 8.7.3 车用芯片格局
 - 8.7.4 车用芯片研发
 - 8.7.5 车用芯片项目
 - 8.7.6 企业战略合作
 - 8.7.7 行业投融资情况
 - 8.7.8 智能驾驶应用
 - 8.7.9 未来发展前景
- 8.8 生物医药领域
 - 8.8.1 生物芯片介绍
 - 8.8.2 市场政策环境
 - 8.8.3 行业产业链条
 - 8.8.4 行业专利数量
 - 8.8.5 企业数量规模
 - 8.8.6 行业应用领域
 - 8.8.7 重点企业分析
 - 8.8.8 行业发展挑战
 - 8.8.9 行业发展前景
 - 8.8.10 行业发展趋势
- 8.9 通信领域
 - 8.9.1 芯片应用状况
 - 8.9.2 射频芯片需求
 - 8.9.3 重点企业分析
 - 8.9.4 5G芯片发展
 - 8.9.5 企业发展动态
 - 8.9.6 产品研发动态

第九章 2021-2023年创新型芯片产品发展分析

- 9.1 计算芯片
 - 9.1.1 行业发展概况

- 9.1.2 市场营收情况
- 9.1.3 技术发展关键
- 9.1.4 产品研发应用
- 9.1.5 企业融资动态
- 9.1.6 发展机遇分析
- 9.1.7 发展挑战分析
- 9.2 智能芯片
 - 9.2.1 AI芯片基本概述
 - 9.2.2 AI芯片政策机遇
 - 9.2.3 AI芯片市场规模
 - 9.2.4 AI芯片市场结构
 - 9.2.5 AI芯片产业链条
 - 9.2.6 AI芯片区域分布
 - 9.2.7 AI芯片应用领域
 - 9.2.8 AI芯片企业布局
 - 9.2.9 AI芯片厂商融资
 - 9.2.10 AI芯片发展前景
- 9.3 量子芯片
 - 9.3.1 技术体系对比
 - 9.3.2 市场发展形势
 - 9.3.3 产品研发动态
 - 9.3.4 关键技术突破
 - 9.3.5 未来发展前景
- 9.4 低功耗芯片
 - 9.4.1 产品发展背景
 - 9.4.2 系统及结构优化
 - 9.4.3 器件结构分析
 - 9.4.4 低功耗芯片设计
 - 9.4.5 产品研发进展

第十章 2021-2023年国际芯片重点企业经营状况分析

10.1 英伟达 (NVIDIA Corporation)

- 10.1.1 企业发展概况
- 10.1.2 2021财年企业经营状况分析
- 10.1.3 2022财年企业经营状况分析
- 10.1.4 2023财年企业经营状况分析
- 10.2 高通 (QUALCOMM, Inc.)
- 10.2.1 企业发展概况
- 10.2.2 2021财年企业经营状况分析
- 10.2.3 2022财年企业经营状况分析
- 10.2.4 2023财年企业经营状况分析
- 10.3 台湾积体电路制造公司
- 10.3.1 企业发展概况
- 10.3.2 2021年企业经营状况分析
- 10.3.3 2022年企业经营状况分析
- 10.3.4 2023年企业经营状况分析
- 10.4 格芯
- 10.4.1 企业发展概况
- 10.4.2 企业合作动态
- 10.4.3 2021年企业经营状况分析
- 10.4.4 2022年企业经营状况分析
- 10.4.5 2023年企业经营状况分析
- 10.5 日月光半导体制造股份有限公司
- 10.5.1 企业发展概况
- 10.5.2 企业业务布局
- 10.5.3 2021年企业经营状况分析
- 10.5.4 2022年企业经营状况分析
- 10.5.5 2023年企业经营状况分析

第十一章 2020-2023年中国大陆重点企业经营状况分析

- 11.1 中芯国际集成电路制造有限公司
- 11.1.1 企业发展概况
- 11.1.2 经营效益分析
- 11.1.3 业务经营分析

- 11.1.4 财务状况分析
- 11.1.5 核心竞争力分析
- 11.1.6 公司发展战略
- 11.1.7 未来前景展望
- 11.2 江苏长电科技股份有限公司
 - 11.2.1 企业发展概况
 - 11.2.2 经营效益分析
 - 11.2.3 业务经营分析
 - 11.2.4 财务状况分析
 - 11.2.5 核心竞争力分析
 - 11.2.6 公司发展战略
 - 11.2.7 未来前景展望
- 11.3 通富微电子股份有限公司
 - 11.3.1 企业发展概况
 - 11.3.2 经营效益分析
 - 11.3.3 业务经营分析
 - 11.3.4 财务状况分析
 - 11.3.5 核心竞争力分析
 - 11.3.6 公司发展战略
- 11.4 天水华天科技股份有限公司
 - 11.4.1 企业发展概况
 - 11.4.2 经营效益分析
 - 11.4.3 业务经营分析
 - 11.4.4 财务状况分析
 - 11.4.5 核心竞争力分析
 - 11.4.6 公司发展战略
 - 11.4.7 未来前景展望
- 11.5 紫光国芯微电子股份有限公司
 - 11.5.1 企业发展概况
 - 11.5.2 经营效益分析
 - 11.5.3 业务经营分析
 - 11.5.4 财务状况分析

11.5.5 核心竞争力分析

11.5.6 未来前景展望

第十二章 2021-2023年中国芯片行业投资分析

12.1 投资机遇分析

12.1.1 投资需求上升

12.1.2 国产化投资机会

12.1.3 产业链投资机遇

12.1.4 资本市场机遇

12.1.5 政府投资机遇

12.2 行业投资分析

12.2.1 市场融资规模

12.2.2 融资轮次分布

12.2.3 融资地域分布

12.2.4 融资赛道分析

12.2.5 投资机构分析

12.2.6 行业投资建议

12.3 基金融资分析

12.3.1 基金投资周期分析

12.3.2 基金投资情况分析

12.3.3 基金减持情况分析

12.3.4 基金投资策略分析

12.3.5 基金投资风险分析

12.3.6 基金未来规划方向

12.4 行业并购分析

12.4.1 全球产业并购现状

12.4.2 全球产业并购规模

12.4.3 国内产业并购特点

12.4.4 企业并购动态分析

12.4.5 产业并购策略分析

12.4.6 市场并购趋势分析

12.5 投资风险分析

- 12.5.1 行业投资壁垒
- 12.5.2 贸易政策风险
- 12.5.3 贸易合作风险
- 12.5.4 宏观经济风险
- 12.5.5 技术研发风险
- 12.5.6 环保相关风险
- 12.6 融资策略分析
 - 12.6.1 项目包装融资
 - 12.6.2 高新技术融资
 - 12.6.3 BOT项目融资
 - 12.6.4 IFC国际融资
 - 12.6.5 专项资金融资

第十三章 中国芯片行业典型项目投资建设案例深度解析

13.1 Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目

- 13.1.1 项目基本概况
- 13.1.2 项目的必要性
- 13.1.3 项目的可行性
- 13.1.4 项目实施进度
- 13.1.5 项目投资概算
- 13.1.6 项目投资效益
- 13.1.7 项目经营前景
- 13.1.8 项目产生影响

13.2 网络通信与计算芯片定制化解决方案平台项目

- 13.2.1 项目基本概况
- 13.2.2 项目的可行性
- 13.2.3 项目投资概算
- 13.2.4 项目实施进度

13.3 工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台项目

- 13.3.1 项目基本概况
- 13.3.2 项目的可行性
- 13.3.3 项目投资概算

- 13.3.4 项目实施进度
- 13.4 超高性能和超低抖动的时钟芯片研发和产业化项目
 - 13.4.1 项目基本概况
 - 13.4.2 项目投资概算
 - 13.4.3 项目实施进度
- 13.5 高性能传感器芯片研发及产业化项目
 - 13.5.1 项目基本概述
 - 13.5.2 项目投资概算
 - 13.5.3 项目实施进度
- 13.6 车载以太网芯片开发与产业化项目
 - 13.6.1 项目基本概况
 - 13.6.2 项目的必要性
 - 13.6.3 项目投资概算
 - 13.6.4 项目实施进度
 - 13.6.5 项目环保情况
- 13.7 网通以太网芯片开发与产业化项目
 - 13.7.1 项目基本概述
 - 13.7.2 项目的必要性
 - 13.7.3 项目投资概算
 - 13.7.4 项目实施进度
 - 13.7.5 项目环保情况

第十四章 2024-2030年中国芯片产业未来前景展望

- 14.1 中国芯片市场发展机遇分析
 - 14.1.1 芯片产业发展机遇
 - 14.1.2 芯片产业发展前景
 - 14.1.3 芯片产业发展趋势
 - 14.1.4 芯片技术研发方向
 - 14.1.5 AI芯片未来发展前景
- 14.2 中国芯片产业细分领域前景展望
 - 14.2.1 芯片材料
 - 14.2.2 芯片设计

- 14.2.3 芯片制造
- 14.2.4 芯片封测
- 14.3 2024-2030年中国芯片行业预测分析
 - 14.3.1 2024-2030年中国芯片行业影响因素分析
 - 14.3.2 2024-2030年中国集成电路产量预测
 - 14.3.3 2024-2030年中国集成电路销售收入预测

第十五章 中国芯片行业政策规划分析

- 15.1 产业标准体系
 - 15.1.1 国外芯片行业扶持政策
 - 15.1.2 中国芯片行业政策汇总
 - 15.1.3 芯片行业政策影响分析
- 15.2 财政扶持政策
 - 15.2.1 进口税收支持政策
 - 15.2.2 企业税收优惠政策
- 15.3 监管体系分析
 - 15.3.1 行业监管部门
 - 15.3.2 并购重组态势
 - 15.3.3 产权保护政策
- 15.4 相关政策分析
 - 15.4.1 智能制造政策
 - 15.4.2 智能传感器政策
 - 15.4.3 “互联网+”政策
 - 15.4.4 人工智能政策
 - 15.4.5 电子元器件行动计划
 - 15.4.6 半导体产业扶持政策
- 15.5 产业发展规划
 - 15.5.1 发展思路
 - 15.5.2 发展目标
 - 15.5.3 发展重点
 - 15.5.4 措施建议
- 15.6 地区发展政策

- 15.6.1 辽宁省集成电路产业发展政策
- 15.6.2 河北省集成电路产业发展规划
- 15.6.3 山东省集成电路产业发展规划
- 15.6.4 江苏省集成电路产业发展政策
- 15.6.5 浙江省集成电路产业发展政策
- 15.6.6 湖北省集成电路产业发展规划
- 15.6.7 甘肃省集成电路产业发展规划
- 15.6.8 江西省集成电路产业发展规划

图表目录

- 图表1 芯片的产业链结构
- 图表2 国内芯片产业链及主要厂商梳理
- 图表3 芯片技术发展的里程碑
- 图表4 芯片生产流程
- 图表5 芯片订货的等候时间
- 图表6 2015-2021年全球芯片销售额
- 图表7 2000-2021全球芯片业销售与资本支出
- 图表8 2021年全球IC公司销售额市场份额
- 图表9 2021年全球前十大晶圆代工业者营收排名
- 图表10 2020年全球各地区芯片产品市场份额
- 图表11 2018-2022年中国台湾IC产业产值
- 图表12 2010-2023年台湾晶圆产值变化
- 图表13 2010-2023年台湾晶圆产量变化
- 图表14 2021年专属晶圆代工排名
- 图表15 2021年中国GDP最终核实数与初步核算数对比
- 图表16 2022年四季度和全年GDP初步核算数据
- 图表17 2017-2022年GDP同比增长速度
- 图表18 2017-2021年货物进出口总额
- 图表19 2021年货物进出口总额及其增长速度
- 图表20 2021年主要商品出口数量、金额及其增长速度
- 图表21 2021年主要商品进口数量、金额及其增长速度
- 图表22 2021年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重

- 图表23 2021年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重
- 图表24 2021-2022年固定资产投资（不含农户）同比增速
- 图表25 2022年固定资产投资（不含农户）主要数据
- 图表26 2017-2021年全部工业增加值及其增长速度
- 图表27 2021-2022年规模以上工业增加值同比增长速度
- 图表28 2022年规模以上工业生产主要数据
- 图表29 2012-2021年电子信息制造业和工业增加值增速情况
- 图表30 2012-2021年电子信息制造业和工业企业出口交货值增速情况

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/414153.html>